

2017-2022年中国ic先进封装行业市场分析预测及 投资前景评估报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2022年中国ic先进封装行业市场分析预测及投资前景评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/301549.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

受性能驱动和成本驱动影响，封装技术路径大致可分为四个阶段：第一阶段为上世纪 80 年代以前，封装的主体技术是针脚插装；第二阶段是从上世纪 80 年代中期开始，表面贴装技术成为最热门的组装技术，改变了传统的 PTH 插装形式，通过微细的引线将集成电路芯片贴装到基板上，大大提高了集成电路的特性，而且自动化程度也得到了很大的提高；第三阶段为上世纪 90 年代，随着器件封装尺寸的进一步小型化，出现了许多新的封装技术和封装形式，其中最具有代表性的技术有球栅阵列、倒装芯片和多芯片组件等，这些新技术大多采用了面阵引脚，封装密度大为提高，在此基础上，还出现了芯片规模封装和芯片直接倒装贴装技术。第四代封装技术以 SiP、WLP 和 TSV 为代表，在凸点技术和通孔技术的基础上，进一步提高系统的集成度与性能。

封装技术发展路径

自 1965 年“摩尔定律”提出以来，微电子器件的密度几乎沿着“摩尔定律”的预言发展。目前，芯片特征尺寸 14nm 已经实现量产，10nm 正在进行试产，7nm 尚属研发阶段，已接近物理极限，再想通过降低特征尺寸来提高电路密度不仅会大幅提高成本，还会降低电路的可靠性。为了提高电路密度，延续或超越“摩尔定律”，藉由先进封装技术成为必然。

SiP 技术将系统或子系统的全部或大部分电子功能配置在整合型基板内，即将原来的三个封装层次（一级芯片封装、二级插板/插卡封装、三级基板封装）浓缩在一个封装层次内，极大地提高了封装密度和封装效率。WLP 技术直接在晶圆上进行大多数或是全部的封装测试程序，之后再行切割（singulation）制成单颗组件，封装尺寸小。TSV 技术在芯片钻出通孔，从底部填充入金属，硅晶圆上以蚀刻或激光方式钻孔，再以导电材料如铜、多晶硅、钨等物质填满，可以实现三维封装，组装密度可达到 200%-300%。

先进封装技术优势

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 产业动态聚焦

第一章 ic封装产业相关概述

第一节 ic封装涵盖

第二节 ic封装类型阐述

一、sop封装

二、qfp与lqfp封装

三、fbga

四、tebga

五、fc-bga

六、wlcsp

第三节 明日之星——tsv封装

一、tsv简介

二、tsv与soc

三、tsv产业与市场

第二章 2016年世界ic封装产业运行态势分析

第一节 2016年世界ic封装业运行环境浅析

一、全球经济大环境及影响分析

二、全球集成电路产业运行总况

第二节 2016年世界ic封装运行现状综述分析

一、ic封装产业热点聚焦

二、ic封装业新技术应用情况

三、全球ic封装基板市场分析

四、全球ic封装材料市场发展

五、全球ic封装生产企业向中国转移

第三节 2016年世界ic封装重点企业运行分析

一、英特尔 (intel)

二、ibm

三、超微

四、英飞凌 (infineon)

第四节 2017-2022年世界ic封装业趋势探析

第三章 2016年中国ic封装行业市场运行环境解析

第一节 2016年中国宏观经济环境分析

一、国民经济运行情况gdp(季度更新)

二、消费价格指数cpi、ppi（按月度更新）

三、全国居民收入情况（季度更新）

四、恩格尔系数（年度更新）

五、工业发展形势（季度更新）

六、固定资产投资情况（季度更新）

七、财政收支状况（年度更新）

八、中国汇率调整（人民币升值）

九、存贷款基准利率调整情况

十、存款准备金率调整情况

十一、社会消费品零售总额

十二、对外贸易&进出口

十三、中国电子产业在国民经济中的地位

第二节2016年中国ic封装市场政策环境分析

一、电子产业振兴规划解读

二、ic封装标准

三、内需拉动业，ic业政策与整合是关键

四、相关行业政策及对ic封装产业的影响

第三节2016年中国ic封装市场技术环境分析

一、高端ic封装技术

二、中高端ic封装技术有所突破

三、ic封装基板技术分析

第四章 2016年中国ic封装产业整体运行新形势透析

第一节 2016年中国ic封装产业动态聚焦

一、半导体封装基板项目落户无锡

二、国内ic封装及ic基板用硅微粉实施产业化

三、中国ic代工封装等已进入国际排行榜

第二节 2016年中国ic封装产业现状综述

一、我国ic封装业正向中高端迈进

二、探密中国ic封装产业变局

三、中国正成为全球ic封装中心

四、ic封装年产能分析

第三节 2016年中国ic封装产业差距分析

一、工艺技术

二、质量管理

三、成本控制

第四节2016年中国ic封装产思考

- 一、技术上：引进和创新相结合
- 二、人才上：引进和培养相结合
- 三、资金上：资本运作是主要途径

第五章 2016年中国ic封装技术研究

第一节 2016年中国ic封装技术热点聚焦

- 一、封装测试技术新革命来临
- 二、芯片封装厂封装技术或转向铜键合
- 三、rfid电子标签的封装形式和封装工艺
- 四、降低封装成本 提升工艺水平措施

第二节 高端ic封装技术

- 一、ic制造技术
- 二、tab potting system
- 三、bga,csp ball mounting system
- 四、flip-chip bonding system
- 五、tab marking system
- 六、tft-lcd cell bonding system

第六章 2016年中国高端ic-3d封装市场探析（3d -ic封装）

第一节3d集成系统分析

- 一、3d-ic封装
- 二、3d-ic集成
- 三、3d-si集成

第二节 2016年中国高端ic-3d封装发展总况

- 一、3d-ic技术蓬勃发展的背后推动力
- 二、3d-ic封装的快速普及
- 三、3d封装技术将显著提升电源管理器件性能
- 四、3d-ic明后年增温 封装大厂已积极布署
- 五、3d封装领域:后进入公司成长空间更大
- 六、3d封装技术解决芯片封装日益缩小的挑战
- 七、3d-ic是半导体封装的必然趋势

第三节 高端ic-3d封装研究进展

- 一、3d芯片封装技术创新

二、tb级3d封装存储芯片

第四节 3d-ic集成封装系统 (sip) 的可行性研究

第七章 2016年中国ic封装测试领域深度剖析

第一节 2016年中国ic封装测试业运行总况

- 一、ic封装测试业外资独占鳌头
- 二、测试企业布局力度将加大
- 三、中高档封测产品占比将逐年提升
- 四、应对知识产权、环保考验

第二节 新型封装测试技术

- 一、mcm(mcp)技术
- 二、sip封装测试技术
- 三、mems技术
- 四、bcc封装技术
- 五、flash memory(tsop)塑封技术
- 六、多种无铅化塑封技术
- 七、汽车电子电路封装测试技术
- 八、strip test(条式/框架测试)技术
- 九、铜线键合技术

第八章 2007-2016年中国ic封装产业数据监测分析

第一节 2007-2016年中国ic封装行业规模分析 (4053)

- 一、企业数量增长分析
- 二、从业人数增长分析
- 三、资产规模增长分析

第二节 2016年中国ic封装行业结构分析

- 一、企业数量结构分析
 - 1、不同类型分析
 - 2、不同所有制分析
- 二、销售收入结构分析
 - 1、不同类型分析
 - 2、不同所有制分析

第三节 2007-2016年中国ic封装行业产值分析

- 一、产成品增长分析
- 二、工业销售产值分析

三、出口 交货值分析

第四节 2007-2016年中国ic封装行业成本费用分析

一、销售成本统计

二、费用统计

第五节 2007-2016年中国ic封装行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第二部分 市场深度剖析

第九章 2016年中国ic封装产业运行新形势透析

第一节 2016年中国ic封装产业运行综述

一、大陆ic封装企业的分布及其特点

二、ic封装向高端技术迈一步

三、形成封装及自主品牌终端产业链

第二节 2016年中国ic封装产业变局分析

一、ic封装业稳步发展，但产值比重有所下降

二、产业格局外企主导，行业竞争日益激烈

三、封装技术更新加快，国内水平显著提高

第三节 金融危机对中国ic封装业影响及应对分析

一、金融危机对封装业冲击较大

二、创新使ic封装企业成功渡过危机

第四节 2016年中国ic封装业面临的挑战分析

一、低档产品封装产能过剩,高端产品的封装刚刚起步

二、ic业“大进大出”的怪圈对封装业的成长提出了挑战

三、我国ic的相关行业配套能力差,也对封装业造成不利影响

四、技术相对滞后

五、国内封装企业自我研发能力差、研发投入不足

第五节 对发展我国ic封装业的思考

第十章 2016年中国ic封装细分市场运行分析

第一节 手机ic封装市场

第二节 手机基频封装

一、手机基频产业

二、手机基频封装

第三节 智能手机处理器产业与封装

第四节 手机射频ic

- 一、手机射频ic市场
- 二、手机射频ic产业
- 三、4g时代手机射频ic封装

第五节 pc领域先进封装

- 一、dram产业近况
- 二、dram封装
- 三、nand闪存产业现状
- 四、nand闪存封装发展
- 五、cpu gpu和南北桥芯片组

第十一章 2016年中国封装用材料运行分析

第一节 金线

第二节 ic载板

第十二章 2016年中国分立器件的封装发展透析

第一节 半导体产业中有两大分支

- 一、集成电路
- 二、分立器件
- 1、特点
- 2、应用

第二节 分立器件的封装及其主流类型

- 一、微小尺寸封装
- 二、复合化封装
- 三、焊球阵列封装
- 四、直接fet封装
- 五、igbt封装
- 六、无铅封装
- 七、几种封装性能同比

第三节 2016年中国分立器件的封装现状综述

- 一、分立器件封装特点
- 二、分立功率半导体市场在封装革命与集成器件挑战下持续扩张
- 三、中国分立器件商贸市场分析
- 四、分立器件封装低端市场竞争激烈
- 五、分立器件：汽车与照明市场扩容 封装重要性凸显

六、封装产品结构调整分立器件价格影响

七、集成电路及分立器件封装测试项目

第三部分 产业竞争力测评

第十三章 2016年中国ic封装产业竞争新格局探析

第一节 2016年中国ic封装竞争总况

一、封装市场竞争激烈

二、倒装芯片封装更具竞争力

三、封装低端市场竞争力加强

四、ic封装技术竞争力分析

五、外资加大中国市场布局对产业竞争的影响

第二节 2016年中国ic封装产业集中度分析

一、市场集中度分析

二、生产企业集中度分析

第三节 2017-2022年中国ic封装竞争趋势分析

第十四章 2016年中国半导体（集成电路）封装重点企业运营财务状况分析

第一节 长电科技（600584）

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 深圳赛意法微电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 南通富士通微电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 英特尔产品(成都)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 无锡菱光科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 恒宝股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 南京汉德森科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节 深圳市比亚迪微电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节 常州市欧密格电子科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十五章 2016年中国芯片封装重点企业关键性财务指标分析

第一节 安靠封装测试(上海)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 沛顿科技(深圳)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 淄博凯胜电子技术有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 河南鼎润科技实业有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 盟事达智能卡技术(深圳)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十六章 2016年中国封装材料企业运营竞争性指标分析

第一节 汉高华威电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 厦门惠利泰化工有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 福建易而美光电材料有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第四节 无锡创达电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第五节 鼎贞(厦门)系统集成有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第六节 无锡市江达精细化工有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第七节 陕西华电材料总公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第八节 无锡嘉联电子材料有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第四部分 产业前瞻与投资战略部署

第十七章 2017-2022年中国ic封装业前景预测分析

第一节 2017-2022年中国ic封装业前景预测

- 一、环氧树脂在电子封装应用方面前景开阔
- 二、太阳能光伏行业对封装材料需求前景光明

第二节 2017-2022年中国ic封装产业新趋势探析

- 一、新型的封装发展趋势
- 二、集成电路封装的发展趋势
- 三、ic封装技术发展趋势
- 四、ic封装材料市场发展趋势
- 五、半导体ic封装技术发展方向

第三节 2017-2022年中国ic封装市场前景预测

- 一、2012年先进电子封装市场可达420亿美元
- 二、全球19家ic封装厂家收入预测
- 三、中国ic封装市场规模预测

第四节 2017-2022年中国ic封装市场盈利预测

第十八章 2017-2022年中国ic封装业投资价值研究

第一节 2016年中国ic封装产业投资概况

- 一、ic封装业投资特性
- 二、ic封装产业投资准入情况
- 三、ic封装投资在建项目分析
- 四、ic封装投资周期分析

第二节 2017-2022年中国ic封装投资机会分析

- 一、ic封装区域投资潜力
- 二、ic封装产业链投资热点分析
- 三、与产业政策调整相关的投资机会分析

第三节 2017-2022年中国ic封装投资风险预警

一、宏观调控政策风险

二、市场竞争风险

三、技术风险

四、市场运营机制风险

五、外资加大中国市场投资影响分析

第四节 专家投资观点

图表目录：

图表：封装尺寸比较

图表：尺寸与热特性对比

图表：部分功率器件封装尺寸

图表：几种封装性能同比

图表：典型无铅焊料再流焊工艺

图表：2005-2016年中国gdp总量及增长趋势图

图表：2009.04-2016年中国月度cpi、ppi指数走势图

图表：2005-2016年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

图表：2005-2016年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

图表：1978-2009中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表：1978-2009中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表：2009-2016年我国工业增加值分季度增速

图表：2005-2016年我国全社会固定资产投资额走势图

图表：2005-2016年我国财政收入支出走势图

图表：2016年美元兑人民币汇率中间价

图表：2009-2016年中国货币供应量月度走势图

图表：2001-2016年2月中国外汇储备走势图

图表：1990-2016年央行存款利率调整统计表

图表：1990-2016年央行贷款利率调整统计表

图表：我国历年存款准备金率调整情况统计表

图表：2005-2016年中国社会消费品零售总额增长趋势图

图表：2005-2016年我国货物进出口总额走势图

图表：2005-2016年中国货物进口总额和出口总额走势图

图表：1978-2014年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图

图表：1978-2014年我国总人口数量增长趋势图

图表：2014年人口数量及其构成

图表：2005-2014年我国普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数走势图

图表：2001-2014年我国广播电视综合人口覆盖率走势图

图表：1978-2014年中国城镇化率走势图

图表：2005-2014年我国研究与试验发展（r&d）经费支出走势图

图表：2007-2016年我国ic封装行业企业数量增长趋势图

图表：2007-2016年我国ic封装行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2007-2016年我国ic封装行业从业人数增长趋势图

图表：2007-2016年我国ic封装行业资产规模增长趋势图

图表：2016年我国ic封装行业不同类型企业数量分布图

图表：2016年我国ic封装行业不同所有制企业数量分布图

图表：2016年我国ic封装行业不同类型企业销售收入分布图

图表：2016年我国ic封装行业不同所有制企业销售收入分布图

图表：2007-2016年我国ic封装行业产成品增长趋势图

图表：2007-2016年我国ic封装行业工业销售产值增长趋势图

图表：2007-2016年我国ic封装行业出口交货值增长趋势图

图表：2007-2016年我国ic封装行业销售成本增长趋势图

图表：2007-2016年我国ic封装行业费用使用统计图

图表：2007-2016年我国ic封装行业主要盈利指标统计图

图表：2007-2016年我国ic封装行业主要盈利指标增长趋势图

图表：全球主要手机基频厂家2008年收入统计

图表：2017-2022年全球主要手机基频厂家封装技术发展预测

图表：12款典型基频封装形式对比

图表：典型手机应用处理器封装对比

图表：2016年全球典型手机应用处理器封装技术

图表：12款典型pa封装对比

图表：13款典型射频收发器封装对比

图表：典型手机其他ic封装技术

图表：2016年全球前十三大品牌厂家出货量统计

图表：2016年中国手机产量前25大厂家产量排行

图表：2017-2022年中国ic封装市场规模预测

图表：2017-2022年中国ic封装市场盈利预测

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/301549.html>